

广发证券股份有限公司

关于锐石创芯（重庆）科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书



二零二五年十二月

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《锐石创芯（重庆）科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》一致。

目 录

声 明.....	1
目 录.....	2
第一节 本次证券发行基本情况	3
一、发行人基本情况	3
二、本次证券发行的基本情况	21
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况	22
四、发行人与保荐人的关联关系	23
第二节 保荐机构的承诺事项	25
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见	26
一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论	26
二、本次证券发行上市所履行的程序	26
三、发行人符合板块定位及国家产业政策的核查情况	27
四、本次发行符合上市条件	34
五、保荐机构对发行人持续督导工作的安排	38
六、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式	39
七、保荐机构认为应当说明的其他事项	39

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称	锐石创芯（重庆）科技股份有限公司
英文名称	RadRock（Chongqing）Tech Co., Ltd.
法定代表人	倪建兴
注册资本	43,444.8089 万元
成立日期	2017 年 4 月 1 日
注册地址	重庆市两江新区龙兴镇明理路 6 号 104
办公地址	重庆市两江新区复兴街道方正大道 500 号
联系人	季飞
邮政编码	401100
互联网网址	http://www.radrocktech.com
电话	0755-26609490
传真	0755-82530132
电子邮箱	ir@radrocktech.com
所属行业	根据国民经济行业分类，属于“C 制造业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”
经营范围	专业化设计服务；集成电路制造；集成电路设计；信息技术咨询服务；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
本次证券发行类型	首次公开发行股票并在科创板上市

（二）发行人的主营业务

锐石创芯（重庆）科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）是一家专注于射频前端芯片及模组的创新企业，致力于突破射频通信领域的核心关键技术，主营业务为射频前端模组及射频分立器件的研发、设计、制造和销售。发行人技术及工艺布局完整涵盖射频滤波器（含双工器、多工器、SAW Bank）、功率放大器、射频开关及低噪声放大器等全品类核心射频器件，具备射频前端高集成度模组开发能力和快速迭代能力。

发行人是国内极少数具备射频滤波器（含双工器、多工器、SAW Bank）生产能力的射频前端模组厂商。鉴于滤波器在射频前端模组中价值占比较高，且长期构成国产高端模组发展的关键瓶颈，发行人在发展早期即前瞻性战略布局该核心环节。2024 年，发行人高性能滤波器晶圆制造基地正式通线投产，标志着发行人成功实现了从 Fabless 设计企业到 Fab-lite 平台型企业的战略转型。依托该基地，发行人已构建覆盖核心器件研发、滤波器自主生产及供应链全面国产化的产业链协同机制，在保障供应链自主可控的同时兼顾运营效率，形成可持续的竞争壁垒。目前，发行人已全面掌握射频前端核心器件与模组集成方案设计、滤波器晶圆制造、高性能模组先进封装工艺及测试机台开发等关键环节的全产业链核心技术优势，高集成度、全国产化的射频前端模组已实现规模化量产。

依托于在射频前端各关键领域的全面技术布局，发行人已建立起完善的产品矩阵。在模组方面，发行人已推出 L-PAMiD、L-PAMiF、DiFEM、LNA Bank、L-FEM、MMMB PAM、TxM 等核心产品，并针对无人机及卫星通信等新兴应用场景推出专用射频前端模组；在分立器件方面，发行人产品涵盖射频滤波器（含双工器、多工器、SAW Bank）、射频开关、低噪声放大器及天线调谐开关等。发行人产品类别全面，覆盖高集成度收发模组、高集成度接收模组、中集成度模组及射频分立器件；通信制式完整支持 5G/4G/3G/2G 等蜂窝通信频段，并拓展至无人机通信与卫星通信等新兴领域。目前，发行人已成为国内射频前端产品覆盖范围最广的企业之一，能够充分满足各类终端客户多样化的应用需求。

在射频前端领域技术门槛最高的 L-PAMiD 高集成度收发模组方面，发行人作为国内极少数成功推出搭载自研自产滤波器的全国产化 L-PAMiD 产品的企业，在该领域实现了关键突破。发行人 Phase 8L L-PAMiD 产品采用完全自主设计、自主生产的双工/多工滤波器，真正实现了从芯片设计、滤波器制造到模组封装测试的全流程国产化，产品多项关键性能指标已达到国际一线水准，在双卡场景下具备卓越的谐波性能，成功突破国际射频前端巨头长期垄断的技术壁垒。当前，国内已实现终端导入及量产出货的 L-PAMiD 产品多数仍依赖进口滤波器。发行人成功推出搭载自研自产滤波器的全国产 L-PAMiD 模组，从根本上增强了供应链的自主可控性，有效消除了因国际贸易环境变化变动可能导致的滤波器断供风险，为下游客户提供了具备可靠供应保障的高端射频前端解决方案。

（三）发行人的核心技术与研发水平

发行人始终坚持创新驱动发展战略，持续开展对射频前端核心芯片及模组化技术的前瞻性研发，并重点布局射频滤波器核心技术与制造工艺。通过持续推进核心滤波器器件的自主设计与制造，发行人有效推动了高集成度、高性能射频前端模组产品的研发与产业化落地，逐步实现射频前端高端高集成度模组核心器件的自主可控。在此过程中，发行人形成了一系列具有自主知识产权的核心技术，并将其持续转化为性能优异、品质可靠的产品，已成为构建发行人核心竞争力的关键支撑。

1、发行人的核心技术

发行人的核心技术均来源于自主研发，为原始创新，不存在对外依赖的情形，并已应用在公司主要产品。截至 2025 年 6 月 30 日，发行人主要核心技术情况如下：

序号	主要核心技术	技术先进性说明	发明专利	技术来源	对应产品
1	功率放大器的高效率、高功率优化技术	通过设置电容切换芯片、偏置电路、电源切换芯片、控制开关，以及通过在放大电路中耦合电容等方式，解决增益平坦和阻抗匹配等问题，提升功率放大器的输出功率和效率，减少射频信号走线之间寄生电容，降低功耗及损耗，从而提升功率放大器整体性能。	CN111106802B CN111293998B CN111342784B CN112260654B CN112968679B CN113871136B CN114039556B CN114915266B CN112688044B CN113241510B	自研	4G 射频前端模组、5G 射频前端模组
2	功率放大器的增益补偿技术	通过在 CMOS 芯片上设置增益补偿装置，对功率放大器的增益随温度的变化进行分段性补偿，提高了功率放大器的热稳定性。	CN111294004B US11843358B2 CN111430131B CN112398448B CN112511119B CN113193844B CN113285684B CN113572433B CN114915274B CN115102512B CN115549614B CN115913152B CN115700998B	自研	射频前端模组控制技术
3	基于差异化 PA 架构的功率放大器高性能优化技术	通过设置匹配网络、增益补偿技术等方式改进推挽功率放大器、多尔蒂功率放大器，保证高效率的同时，提升功率放大器线性度、工作带宽等整体性能，兼顾变压器的面积和集成度，提升推	CN115021685B	自研	功率放大器、射频前端模组

序号	主要核心技术	技术先进性说明	发明专利	技术来源	对应产品
		挽功率放大器、多尔蒂功率放大器整体的性能指标。			
4	射频开关的谐波抑制技术	通过外部调谐电压对射频调谐网络产生的电容值进行调谐，有效地减少了射频信号施加在射频开关上时射频开关产生的谐波，实现对射频开关的谐波抑制。	CN112272017B	自研	4G 射频前端模组、5G 射频前端模组、独立射频开关
5	支持高耐压、低插损的射频开关设置技术	通过合理配置和优化发射路径中射频开关的电路连接关系，即合理配置各个射频开关的数量、分布以及每一射频开关的晶体管数量，保证射频开关电路具有在能保证承受足够高的电压/功率的同时又能降低所引入的插入损耗，且通过优化发射路径中射频开关的配置，提高了不同发射路径之间的隔离度，避免了不同发射路径的射频信号相互干扰。	CN112235013B CN113395081B CN113595579B CN115987263B	自研	4G 射频前端模组、5G 射频前端模组、独立射频开关
6	低噪声放大电路优化技术	通过公共衰减模块、补偿调整电路、阻抗调节网络、减缓寄生电容相等所导致的阻抗失配问题，提高低噪声放大电路的线性度，优化低噪声放大器性能。	CN111953311B CN111953374B CN112671357B CN112821907B CN114567271B	自研	中集成度接收模组，高集成度接收模组，各类收发模组等模组
7	多频段功率放大器的偏置电路优化技术	通过构建可切换环路增益的供电网络，向功率放大器提供偏置信号，并在功率放大器因工作在多个频段而产生不同的环路增益时将其消除，从而消除了不同频段时闭合环路内的震荡，避免了闭合环路产生震荡，实现了不同的环路增益特性，用一个网络就可以提高两个频段的稳定性。	CN111030079B	自研	4G 射频前端模组、5G 射频前端模组
8	高集成度、高性能多天线链路架构技术	通过优化射频前端模块布局 and 天线设置，实现使用较少芯片完成多路发射和接收、提高信道容量的同时，可灵活控制和调整所需接入的不同的频段信号，加大其调试自由度、提升隔离度避免信号干扰，优化射频前端模块的性能、减少体积。	CN111565057B CN111600616B CN111917429B CN112994736B CN113162649B CN113225095B CN115801039B	自研	5G 射频前端模组
9	射频前端模组的高集成技术	在保证功率放大器整体性能不变的情况下，通过减少功率放大器中的器件数量、优化晶体管阵列方式、金属线传输方式以及优化转换变压器的设置方式等，降	CN111555763B CN112422144B CN112187194B CN114268283B CN114039555B	自研	4G 射频前端模组、5G 射频前端模组

序号	主要核心技术	技术先进性说明	发明专利	技术来源	对应产品
		低功率放大器的电路结构复杂度、减小占用面积、降低芯片的整体损耗，在兼顾性能的前提下，降低放大器的基板设计面积或者设计层数,减少射频前端模组尺寸、增加集成度。			
10	射频前端接收模组的裸芯片封装技术	倒装芯片安装工艺要求部分特殊功能的芯片在封装过程中要求与基板之间具有空腔结构，以满足其功能、性能或者其他特殊的要求。通过调整芯片封装结构设置、引入防护层、设置承载结构等提高芯片封装结构的稳定性，保证了芯片整体性能的实现，提高了芯片的可靠性。	CN115000024B CN115000025B	自研	高集成度接收模组、高集成度收发模组等射频前端接收模组
11	声表面波滤波器、多工器的封装技术	声表面波滤波器、多工器滤波器的封装技术，可以在多个芯片均形成有效、稳定的空腔结构，避免填充料受热膨胀导致封装结构不稳定，减少芯片连接点高温重熔后可能出现的焊点脱离的风险，提高滤波器封装的可靠性、稳定性。同时，可以减少多个芯片的间距，提高了芯片封装结构整体的集成度。	CN114726333B	自研	滤波器（含双工器、多工器）
12	声表面波滤波器、多工器的设计、制造技术	通过声表面波滤波器、多工器的设计、制造技术，减少寄生电容的产生，提高滤波器的带外抑制水平，优化射频信号的滤波效果，提高声表面波滤波器的可靠性，减少插损，提高声表面波器件的 Q 值，提高滤波器整体性能。	CN114301422B CN115940869B CN116073780B CN116318043B CN116938189B	自研	滤波器（含双工器、多工器）
13	射频前端芯片的测试方案技术	通过搭建符合一套具备通用性的芯片测试选通模块，实现可根据不同测试要求灵活调整模块的切换状态，并通过集成符合公司产品特点的测试设备和开发测试方案，提高测试精准度、测试效率、缩短产品研发和认证周期。	CN112467325B CN113363691B CN113484735B	自研	4G 射频前端模组、5G 射频前端模组、独立射频开关、独立滤波器
14	无人机射频前端模组设计	通过搭建新型三级差分架构，同时彻底规避震荡自激隐患，提高射频前端模组整体的信噪比和增益，使得飞行器图传及控制距离大大增加，抗干扰能力也能够增强。	CN118098780A CN118645340A （在审） CN119420298A （在审）	自研	无人机射频前端模组
15	卫通通信射频	通过使用多级推挽类放大器架	CN117097278B CN116722829B	自研	卫星通信模

序号	主要核心技术	技术先进性说明	发明专利	技术来源	对应产品
	前端	构，显著降低其静态功耗，且可以有效驱动低阻负载，增强失真控制能力。增强放大器在卫星通信频段上的抗干扰能力和发射功率。	CN116054748B CN117728780B CN115549617B CN115913152B CN112968679B CN113285684B		组

2、发行人的研发水平

发行人依托其业内一流的研发团队，在射频前端全领域已形成了完善的技术储备。凭借强大的研发实力，发行人参与了多个省级和市级重大科研课题并积累了一系列知识产权和荣誉奖项。截至 2025 年 6 月 30 日，发行人拥有授权专利 330 项，其中发明专利 144 项，另有在审发明专利 228 项。具体如下：

（1）研发团队方面

发行人高度重视人才队伍建设，通过内部培养和外部引进等方式，已形成了一支具有国际竞争力的高素质人才队伍。截至 2025 年 6 月末，发行人研发人员为 222 人，占员工总数的比例为 59.36%，其中硕博士占研发人数比例约 47.75%。发行人多名研发人员曾深度参与“01 专项”和“03 专项”等国家科技重大专项或曾荣获“国家科学技术进步一等奖”。

公司董事长、总经理倪建兴先生深耕射频前端行业多年，具备深厚的研发背景，全面负责公司的整体技术研发工作。发行人核心研发团队拥有在国内外领先厂商的长期工作经验，对射频前端行业具备深刻的行业理解，教育及工作背景涵盖射频微波、材料科学、信号与系统、电磁场、电路分析等多学科，对行业有深刻理解并保持高度技术敏感性。发行人研发团队研发方向涵盖射频功率放大器、低噪声放大器、射频开关、滤波器等元器件和模组的设计、晶圆材料应用、芯片及模组测试、封装技术等各方面。发行人已经建立起较为完善的研发制度和方法论，拥有前瞻性的研发方向和行业领先的技术储备，为发行人不断推出高集成度、高性能的射频前端产品奠定了坚实的基础。

发行人前瞻布局滤波器研发与自主制造能力，已构建覆盖滤波器设计、工艺开发、测试验证及生产管理的全技术链人才队伍。发行人滤波器技术团队具备 SAW、TC-SAW、ML-SAW（POI 衬底）和 F-BAR 等多技术路线滤波器的设计

开发能力，并建立了成熟的工艺开发、测试验证与量产质量控制体系，实现了从滤波器设计到规模量产的全流程自主可控。

（2）专利技术布局方面

发行人在射频前端领域具备丰厚的技术积累。截至 2025 年 6 月末，发行人已授权发明专利 144 项，在审发明专利共计 228 项，其专利布局完整覆盖滤波器（含双工器、多工器、SAW Bank）、功率放大器、射频开关、低噪声放大器、射频模组集成及封装测试等领域，现已成为国内射频前端领域专利技术布局最全面的公司之一。

（3）研发投入方面

报告期内，发行人研发投入分别为 25,351.17 万元、27,246.72 万元、21,597.86 万元和 10,001.22 万元，占营业收入比例分别为 68.52%、41.97%、32.30%和 26.51%，占比较高。发行人属于技术驱动型企业，保持足够的技术研发投入是保持发行人产品竞争力的关键，公司在报告期内持续加大技术研发投入，剔除股份支付影响后的研发费用金额逐年增长。

综上，发行人拥有完整的研发体系、经验丰富的研发团队、全面的专利技术布局。射频前端行业为技术密集型行业，发行人持续保持较高的研发投入力度，在高端射频模组产品上不断实现技术突破，积累了较高的研发水平。

（四）发行人的主要经营和财务数据及指标

财务指标	2025-6-30/ 2025 年 1-6 月	2024-12-31/ 2024 年度	2023-12-31/ 2023 年度	2022-12-31/ 2022 年度
资产总额（万元）	153,905.80	134,933.38	138,305.90	132,030.42
归属于母公司所有者权益（万元）	80,677.74	12,939.90	45,968.01	67,720.71
资产负债率（合并）（%）	47.58	90.41	66.76	48.71
资产负债率（母公司）（%）	37.30	69.02	40.99	21.84
营业收入（万元）	37,728.26	66,860.93	64,913.01	37,000.09
净利润（万元）	-14,836.62	-35,296.14	-32,822.41	-32,827.68
归属于母公司所有者的净利润（万元）	-14,836.62	-35,296.14	-32,822.41	-32,827.68
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	-15,081.15	-36,581.79	-26,961.09	-29,943.34

财务指标	2025-6-30/ 2025 年 1-6 月	2024-12-31/ 2024 年度	2023-12-31/ 2023 年度	2022-12-31/ 2022 年度
基本每股收益（元）	-0.38	-0.92	-0.86	-0.87
稀释每股收益（元）	-0.38	-0.92	-0.86	-0.87
加权平均净资产收益率（%）	-103.10	-120.57	-57.74	-46.90
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-13,881.78	-26,157.73	-22,182.21	-4,183.08
现金分红（万元）	-	-	-	-
研发投入占营业收入的比例（%）	26.51	32.30	41.97	68.52

上述指标的计算公式如下：

（1）资产负债率=负债总额/资产总额

（2）加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

（3）基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

（4）稀释每股收益= $[P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 。

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

（5）研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入

（五）发行人存在的主要风险

1、与发行人相关的风险

（1）技术风险

①技术和产品迭代的风险

通信制式标准的不断演进带来了射频前端产品的技术标准及产品类型的迭

代。公司的射频前端产品主要应用于智能手机、物联网、卫星通信、无人机及智能穿戴设备等射频通信相关领域，上述行业产品迭代速度快、市场需求变动频繁，要求射频前端企业制定前瞻性的产品路线、在研发和经营上保持强有效的执行力、不断整合资源，及时推出符合市场需求的产品并导入到终端客户。如公司产品路线不符合市场需求或研发迭代未达预期，导致公司未能及时提供符合客户需求的产品，则公司将面临产品被替代或淘汰的风险。

在当前射频前端技术快速演进的背景下，产品正持续向高集成度、高性能与高性价比方向迭代发展。高集成度模组产品的普及，对射频前端企业在全系列射频器件的技术能力，尤其是在滤波器领域的核心技术积累与系统级模组集成能力，提出了更为严格的要求。若公司未能持续保障研发投入、关键技术迭代滞后或研发方向与市场需求产生偏差，导致新产品无法及时推出，将对公司营业收入及经营业绩造成负面影响。

②技术人才储备不足及流失的风险

集成电路行业属于技术和人才密集型行业，企业间对人才的争夺竞争日趋激烈。公司所处的射频前端领域作为典型的技术密集型领域，深度融合了数字信号、模拟信号及射频信号处理技术，跨越射频微波、材料科学、信号与系统、电磁场、电路分析等多学科知识体系。为有效推动技术研发并实现滤波器自主制造，公司不仅需要具备多学科背景的研发团队，更亟需精通材料特性、工艺开发和晶圆制造的制造类人才。当前，具备上述跨领域经验的复合型人才在行业中高度稀缺。

随着公司业务规模的持续扩大及中高集成度产品线的不断拓展，公司需要不断吸纳及培养覆盖芯片设计、模型构建、晶圆工艺开发、封装与测试等全流程的优秀技术人才。然而，公司当前研发团队整体规模仍与国际领先的射频前端企业存在一定差距。若未来无法持续引进并保留高端技术人才，或出现核心骨干人员大规模流失，将对公司的技术研发、产品迭代及整体经营业绩带来不利影响。

③技术秘密泄露的风险

持续的研发创新及基于此形成的核心技术是公司保持竞争优势的有力保障。当前公司多项高集成度核心技术产品尚处于研发阶段，技术的保密对公司发展尤

为重要，如公司在经营过程中因核心技术信息保管不善、技术人员违反保密合同或者信息系统漏洞等导致核心技术泄密，将对公司的核心竞争力产生不利影响。

（2）尚未盈利且存在累计未弥补亏损的风险

①报告期内亏损且持续亏损的风险

报告期内，公司净利润分别为-32,827.68 万元、-32,822.41 万元、-35,296.14 万元和-14,836.62 万元，最近一期尚未实现盈利。

公司报告期末存在未弥补亏损，主要系报告期内公司产品毛利率相对较低、研发投入规模较大，并因实施员工股权激励计划确认大额股份支付费用所致。由于射频前端行业技术壁垒高、研发周期长、产品认证及客户导入流程严谨，公司在可预见期间内仍将持续保持较高水平的研发投入。若未来出现下游市场需求增速放缓、行业竞争加剧导致产品价格下行、新产品研发或客户认证进度不及预期、毛利率改善缓慢等情况，可能导致公司无法如期实现规模经济及盈利，面临持续亏损与未弥补亏损进一步扩大的风险。

②公司短期内无法进行利润分配的风险

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人未分配利润金额为-167,972.04 万元，存在累计未弥补亏损。若公司未来在产品研发和市场推广方面进度未达预期，公司存在未来一段时间持续亏损和未弥补亏损进一步扩大的风险。预计首次公开发行股票并在科创板上市后，公司可能在短期内无法进行现金分红，并对股东的投资收益造成不利影响。

③业务战略受到影响的的风险

报告期内，公司的营运资金周转依赖于外部融资。如公司持续亏损且无法通过其他渠道筹集资金，将影响公司日常经营所需要的现金流，进而对公司业务拓展、团队稳定、人才引进、研发投入等业务战略实施造成不利影响。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-4,183.08 万元、-22,182.21 万元、-26,157.73 万元和-13,881.78 万元。尽管报告期内公司营业收入整体呈上升趋势，但由于毛利率低、研发费用持续增长、存货规模扩大等情况，

导致公司经营活动产生的现金流量净额持续为负。未来，如公司业务发展不达预期，无法形成规模效应并实现盈利，则公司经营活动产生的现金流量净额将无法得到改善，可能对公司资金链、经营业绩造成重大不利影响。与此同时，公司面临的资金压力也将影响公司员工薪酬的发放和增长，从而影响公司现有团队的稳定和未来人才的引进，进而阻碍公司研发及商业化目标的实现，影响公司业务战略的实施。

（3）经营风险

①品牌客户拓展不及预期或合作关系发生不利变化的风险

产品成功导入品牌客户机型并通过验证、量产是射频前端企业技术实力与产品优势的重要体现。射频前端企业的手机终端客户主要有苹果、三星、OPPO、小米、vivo、华为、荣耀、传音、中兴等全球性手机品牌，这些品牌厂商非常重视产品质量与品牌信誉度，在供应链导入方面要求严格，需要历经导入资格预审、器件单体验证、可靠性验证、上游供应链审核、器件板级验证、百 K 级试产验证、出货量爬坡、质量表现确认等多个环节，因此国产射频前端企业验证导入的时间周期一般较长。

公司正在积极拓展国内外知名品牌终端客户，持续深化与该等知名客户的合作，但公司产品验证周期较长，市场拓展效果受到客户整体战略规划、市场偏好及竞争对手策略等多重因素的影响。若公司不能准确把握品牌客户的市场需求，主要产品在品牌客户现有机型或新机型的验证导入中失败或推进不及预期，公司将面临品牌客户开拓不及预期或与品牌厂商合作关系发生不利变化、订单减少、市场份额下降的风险，进而对公司的经营情况产生不利影响。

②高集成度射频前端模组导入不及预期的风险

在射频前端市场中，L-PAMiD 等高集成度模组作为移动通信链路中的核心模块，其性能与可靠性对终端通信质量具有重大影响，因此终端客户对该类产品的认证标准较严格、导入周期较长。公司自建滤波器产线投产时间较短，自产滤波器在高集成度模组中的实际应用验证尚需进一步积累，可能在一定程度上制约集成自产滤波器的高端模组在终端客户中的快速导入与批量出货进度，从而对相

关产品的快速导入与规模出货造成不确定性，进而对公司市场竞争力和未来经营业绩带来不利影响。

③客户集中度较高的风险

公司主要通过经销或直销方式向品牌手机厂商、ODM 厂商或物联网模组厂商销售产品。由于下游终端客户的集中度较高，使得公司的客户集中度也较高。报告期内，公司前五大客户收入占比分别为 79.25%、69.60%、67.12%和 71.29%。若主要客户经营情况和市场份额或公司产品在主要客户中的竞争地位发生不利变化，将对公司的经营情况产生不利影响。

④供应商集中度较高的风险

集成电路产业链包括了芯片设计、晶圆制造、封装测试等核心环节。报告期内，公司采购的物料主要为晶圆、基板、无源器件及衬底材料，采购的服务主要为封装测试服务。由于半导体制造及测试领域设备资金投入金额大、工艺技术门槛及专业化分工程度高，导致晶圆代工及封装测试服务供应商资源集中，可替代的公司较少，使得公司的供应商集中度较高。同时，终端客户通常对其上游供应链设有严格的认证与导入程序。若产品的上游供应商发生变更，通常需在终端客户处重新履行相关认证与导入流程，该过程通常需耗费较长时间及资源。报告期内公司前五大供应商采购占比分别为 61.15%、54.03%、63.92%和 59.67%。公司自成立以来坚定推进供应链国产化战略，已与华虹宏力、三安集成等国内领先晶圆代工企业形成深度合作。报告期内，采用全国产晶圆的射频前端模组及分立器件已通过头部客户的认证并实现稳定量产。

未来，若因供应商所提供的产品或服务出现质量问题，或受其自身产能波动等不可控因素影响，导致公司与该供应商的合作关系发生中断或终止，公司可能面临无法及时确定合格替代供应商的风险，可能导致公司出现产品无法及时交付的风险，进而对公司的生产经营业绩产生不利影响。

⑤研发投入较大及研发失败的风险

报告期内，公司研发费用分别为 25,351.17 万元、27,246.72 万元、21,597.86 万元和 10,001.22 万元，占营业收入比例分别为 68.52%、41.97%、32.30%和

26.51%。

公司作为技术驱动型企业，保持较高水平的研发投入是维持产品技术领先性和核心竞争力的关键。报告期内，公司持续增加研发费用规模，剔除股份支付影响后，研发投入金额逐年增长，占营业收入的比例总体呈上升趋势。在未来可预见的期间内，公司仍将维持较大规模的研发支出。若在研发过程中出现技术路线与市场需求偏离、关键技术未能突破或研发成果产业化不及预期等情况，可能导致部分研发项目失败或未能实现预期效益，从而对公司的竞争优势与经营业绩产生不利影响。

⑥产品质量风险

在通信系统中，射频前端是无线通信中的信号发射及接收的核心部件，直接影响智能终端的信号收发质量，客户对射频前端产品的一致性及稳定性要求较高。如果公司产品质量未能达到客户的要求、上游供应商提供的产品出现一致性或稳定性不足等质量问题，将对公司的经营发展产生重大不利影响。

（4）财务风险

①存货余额较大及跌价的风险

公司存货主要由原材料、库存商品、委托加工物资组成，公司一般结合销售计划及公司库存情况制定采购计划及生产计划，并结合市场变化及上游供应商产能情况动态调整存货库存水平。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 17,948.83 万元、25,875.31 万元、31,767.40 万元和 34,378.12 万元，占公司流动资产比例分别为 21.72%、34.20%、43.29%和 36.62%，占比较高。

公司已根据企业会计准则及公司实际情况，审慎制定了存货跌价准备计提政策。报告期各期末，公司对存货进行减值测试，按照存货成本与可变现净值孰低的原则，对存货可变现净值低于成本的部分计提存货跌价准备。同时，公司会综合考虑存货库龄因素，对个别库龄较长的存货单独全额计提存货跌价准备。报告期各期末，存货跌价准备金额分别为 4,844.06 万元、7,603.44 万元、11,834.98 万元和 11,609.10 万元，占存货账面余额的比例分别为 21.25%、22.71%、27.14%和 25.24%，计提金额及比例较高。

未来，如因市场需求变化、市场竞争加剧或公司产品竞争力下降导致产品无法顺利实现对外销售，或公司未能结合市场变化情况对存货库存水平进行动态调整，则公司将面临存货积压及存货跌价准备计提金额上升的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

②毛利率偏低的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 7.95%、13.90%、8.79%和 9.79%，其中 5G 射频前端模组产品的毛利率分别为 23.55%、20.65%、8.74%和 11.49%，4G 射频前端模组产品的毛利率分别为 6.52%、8.94%、6.27%和 7.78%，无人机射频前端模组毛利率分别为-22.85%、43.25%、42.93%和 27.23%。报告期内，公司毛利率整体仍处于较低水平，且受市场竞争加剧等因素的影响，5G 射频前端模组产品的毛利率出现持续下滑。未来，如公司不能持续进行产品迭代升级导入高端产品或不能持续进行产品优化设计以降低产品成本，则公司将存在毛利率无法继续提升、毛利率偏低甚至转负的风险，进而影响公司的盈利能力。

③股份支付费用对公司损益影响较大的风险

集成电路设计行业属于技术和人才密集型行业，射频前端企业的人才紧缺程度较为突出，通过股权对员工进行激励符合公司及行业的情况。报告期各期，公司确认的股份支付费用分别为 11,801.05 万元、11,069.71 万元、1,550.70 万元和 1,070.38 万元，合计金额约 25,491.84 万元，对公司报告期内业绩影响较大。

由于部分股权激励具有服务期，按激励对象所属的类别计入各期间费用，并作为经常性损益，对公司未来损益及股东回报也会产生一定影响。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已实施的股权激励对应的股份支付相关费用尚未摊销完毕，预计未来随着员工服务期摊销，将会对未来公司净利润造成不利影响。

④经营活动现金流量为负的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-4,183.08 万元、-22,182.21 万元、-26,157.73 万元和-13,881.78 万元。公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，主要系为应对订单量增长而提前进行存货储备，导致采购支出规模较大；同时公司为保持产品竞争力，持续加大研发投入及人才引进力度，相

关职工薪酬支出显著增加。若公司未来不能改善经营活动现金流状况，且未能通过外部融资等方式及时补充营运资金，可能对资金周转及业务发展造成不利影响。

⑤人民币汇率波动的风险

公司存在境外采购和销售以外币结算的情况，受外币兑人民币汇率波动影响，报告期内计入财务费用的汇兑损益金额分别为-659.60万元、-624.99万元、-19.50万元和156.91万元。未来，随着公司业务规模的增长，预计境外交易金额会进一步增加，如国内外政治、经济环境发生变化，使得人民币汇率发生大幅波动，将对公司经营业绩产生一定影响。

（5）法律风险

①知识产权风险

公司所处行业属于技术密集型行业，在技术研发以及产品开发过程中，涉及较多专利及计算机软件著作权等知识产权。截至报告期末，公司拥有授权专利330项，其中发明专利144项、实用新型专利186项；集成电路布图设计专有权176项。公司已进行自身知识产权的申报和保护，并避免侵犯他人知识产权，但公司无法排除竞争对手、其他利益相关方通过恶意诉讼或其他手段发起知识产权争议或纠纷，从而干扰公司正常业务发展的情况。

与此同时，公司已通过与核心员工签署保密协议及竞业限制协议等方式对自主知识产权进行保护，但公司亦不能排除在后续业务开展过程中出现技术人员违反保密合同、竞业限制协议或因技术资料保管不善、信息系统漏洞等原因导致公司关键知识产权被窃取、被模仿的风险，公司亦无法排除所拥有的知识产权被有权机关宣告无效或撤销的风险。

②研发软件授权风险

公司在研发过程中需使用电子设计自动化（EDA）软件，目前相关工具主要由境外供应商提供，公司已通过合法授权方式取得其使用许可。近年来国际贸易环境存在不确定性，尽管公司目前所使用的EDA软件未直接受到贸易限制，但如果未来国际贸易争端加剧，导致境外EDA供应商授权政策发生变更，或出现

断供、禁运等情形，可能对公司研发进程和技术迭代造成不利影响，进而对整体经营发展带来潜在风险。

③实际控制人持股比例较低的风险

截至本上市保荐书签署日，倪建兴直接持有发行人 12.0997%的股份，并通过平潭锐石、平潭锐势间接控制发行人 13.5771%的表决权，合计控制发行人 25.6767%的表决权，为发行人控股股东、实际控制人。倪建兴为公司创始人，自公司成立以来一直担任公司董事长、总经理，能控制、影响公司总体战略部署和日常经营决策。

本次发行后，倪建兴控制公司的股份比例将进一步减少。公司实际控制人控制的表决权比例较低，存在公司控制权不稳定的风险，可能会对公司业务开展及经营管理产生不利影响。

（6）募投项目风险

①募投项目实施效果未达预期的风险

公司本次募集资金主要用于“MEMS 器件生产基地二期工程建设项目”和“研发中心建设项目”。“MEMS 器件生产基地二期工程建设项目”将用于扩大公司 SAW、TC-SAW、ML-SAW（POI 衬底）等滤波器的生产能力，所生产的滤波器将与公司现有的 PA、LNA 及射频开关等技术相结合，为公司高集成度射频前端模组带来极大的协同效应。随着 5G 通信向高频段、载波聚合等复杂场景演进，高集成度射频模组（如 L-PAMiD、L-DiFEM）的市场需求持续增长，而滤波器作为模组核心器件，其自产能力与产能直接决定了公司的产品竞争力。

由于本次募集资金投资项目的投资金额较大，项目管理和组织实施是项目成功与否的关键。若投资项目因技术、需求、宏观经济环境不利变化等因素影响不能按期完成，将对公司的盈利状况和未来发展产生不利影响。与此同时，募集资金投资项目建设需要时间，若未来市场需求出现较大变化，或者公司不能有效拓展市场，将导致募投项目成果转化存在较大不确定性。

②募投项目实施后费用大幅增加的风险

随着募投项目逐步实施，公司将新增大量的研发投入、固定资产及无形资产购置支出，导致年新增折旧及摊销费用较大。若行业或市场环境发生重大不利变化，募投项目成果转化不及预期，则募投项目费用支出的增加可能对公司盈利能力产生不利影响。

2、与行业相关的风险

（1）行业市场竞争激烈的风险

全球射频前端市场现阶段仍由 Broadcom、Qualcomm、Skyworks、Qorvo 及 Murata 等美国、日本射频前端厂商主导。上述国际知名射频前端厂商成立时间早，在资金规模、技术储备、工艺水平及品牌影响力等方面形成了较强的综合竞争优势。该类企业普遍具备射频前端全系列核心芯片与器件的自主设计、规模化量产及模组集成能力，并通过持续高强度的研发投入巩固其技术领先地位与市场竞争力。依托其在滤波器等关键领域的 IDM 模式优势，国际厂商在制造工艺、成本控制及模组小型化方面构筑了较高壁垒，对后发企业构成持续的竞争压力。

中国射频前端行业起步相对较晚，目前市场份额仍主要由境外头部企业占据。国内企业多集中于中低集成度产品领域，该领域产品同质化程度较高，且持续面临高集成度产品替代及激烈价格竞争的压力。在高端高集成度模组市场，美系及日系厂商凭借技术积累和先发优势占据主导地位，持续挤压后发企业的市场空间。目前，国产高集成度模组中的核心器件滤波器仍较多依赖进口，在模组进一步小型化、高性能化方面与国际领先水平存在差距的同时，产业链还面临国际贸易环境变动带来的潜在供应风险。

在此市场竞争环境下，若同行业公司持续采取渗透定价等激进市场策略，公司部分产品可能面临进一步的价格压力；若公司未能及时准确把握行业趋势与客户需求，未能持续推出具有竞争优势的高性价比或高集成度产品，或未能有效优化成本结构、提升产品性能，则可能对公司的行业地位、市场份额及盈利能力产生不利影响，并可能导致毛利率下滑、经营业绩承压。

（2）行业下游应用领域市场规模增长缓慢的风险

公司产品主要应用于智能手机、智能穿戴设备、物联网模组及无人机等消费

电子领域。根据 IDC 统计数据，全球智能手机出货量在 2022 年及 2023 年连续出现同比下降，2024 年虽实现同比回升，但整体来看，近年来全球智能手机市场总容量增长趋缓。随着 5G 技术普及程度提升，终端换机需求有所减弱，预计未来手机出货量将趋于平稳，难以出现大幅增长。该市场态势可能导致下游客户对射频前端芯片及相关器件的采购需求减少，若公司未能有效拓展产品应用领域或提升市场份额，可能面临营业收入下滑的风险。

（3）原材料及封装测试服务采购价格波动的风险

公司目前经营模式为 Fab-lite，除滤波器晶圆外的其他晶圆、无源器件、基板等主要原材料及封测服务均由外部供应商供应。由于公司所处行业周期性较强，上游供应商较为集中，导致原材料及封测服务的产能及相应的采购价格波动性较大。且下游终端客户在认证导入公司产品时，会同步对上游材料及封测供应商进行认证，供应商切换成本较高、周期较长。报告期内，受行业周期波动的影响，公司采购的晶圆及封测服务的价格也出现不同程度的波动。未来如公司不能准确预判行业周期，不能采取有效措施应对行业周期波动带来的原材料及封装测试服务采购价格波动风险，则将对公司产品供应的稳定性及经营业绩产生不利影响。

3、其他风险

（1）国际贸易摩擦风险

近年来，全球政治和经济形势紧张，国际贸易摩擦升级，逆全球化及单边贸易保护主义趋势出现。集成电路属于全球高度分工行业，国内射频前端企业和上游国内供应商均不同程度采购国外原材料、设备或软件，贸易摩擦的加剧可能导致公司的产品供应受到不利影响。

与此同时，公司下游终端客户产品销售范围覆盖全球，也在不同程度采购国外原材料、设备或软件，如贸易摩擦进一步加剧或被某些国家列入受限制“实体清单”，将影响其生产和销售，从而对公司经营情况产生不利影响。

（2）发行失败的风险

公司本次申请首次公开发行股票并在科创板上市，发行结果受到发行时国内

外宏观环境、证券市场整体情况、半导体行业相关市场情况、投资者对公司价值判断等多种因素的综合影响，若本次发行时有效报价投资者或网下申购投资者数量不满足法律规定要求，发行时总市值未能达到预计市值上市条件，或者存在其他影响发行的不利情形，将导致本次发行存在发行失败的风险。

二、本次证券发行的基本情况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股 A 股		
每股面值	1.00 元		
发行股数	不低于 4,827.2010 万股且不高于 10,861.2022 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）	占发行后总股本比例	不低于 10.00%且不高于 20%
其中：发行新股数量	不低于 4,827.2010 万股且不高于 10,861.2022 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）	占发行后总股本比例	不低于 10.00%且不高于 20%
股东公开发售股份数量	无	占发行后总股本比例	无
发行后总股本	不低于 48,272.0099 万股且不高于 54,306.0111 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）		
每股发行价格	【】		
发行市盈率	【】倍（按询价后确定的每股发行价格除以每股收益确定，其中每股收益按【】年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	【】元/股（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）	发行前每股收益	【】元/股（按【】年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元/股（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）	发行后每股收益	【】元/股（按【】年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	本次发行将采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，或者中国证监会、上交所认可的其他发行方式		
发行对象	本次发行将采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的持有上海市场非限售 A 股股份和非限售		

	存托凭证市值的社会公众投资者定价资金申购发行相结合的方式 进行，或者中国证监会、上交所认可的其他发行方式
承销方式	余额包销
募集资金总额	【】万元
募集资金净额	【】万元
募集资金投资项目	MEMS 器件生产基地二期工程项目 射频前端研发中心建设项目 补充流动资金
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，包括：保荐及承销费用【】万元、审计及验资费用【】万元、律师费用【】万元、与本次发行相关的信息披露费用【】万元、上市相关手续费用及其他费用【】万元
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况（如有）	若发行人高级管理人员、员工拟参与本次发行战略配售，则发行人将依据相关法律法规的要求，在本次公开发行股票发行前适时履行相应审议程序及其他必备程序，并依法进行披露
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况（如有）	保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行；保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则（如有）	无
（二）本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况

（一）本次证券发行上市的保荐代表人情况

陈昊田先生，保荐代表人，中国注册会计师非执业会员，澳大利亚注册会计师会员，会计与金融学硕士。2017 年开始从事财务审计业务，2020 年开始从事投资银行业务。曾参与华宝股份（300741.SZ）、优必选科技、深达威科技等多家企业的改制、辅导与首次公开发行股票并上市工作及多家上市公司的年度审计工作，具备丰富的财务会计知识和投资银行业务知识。自执业以来，执业记录良好，未受到监管部门的处罚。

鲁学远先生，保荐代表人，现任广发证券投行业务管理委员会总监。曾主持或参与新益昌科创板首次公开发行股票并上市、深圳瑞捷首次公开发行股票并上市、深达威首次公开发行股票并上市、欣旺达定向增发、隆利科技定向增发、多家公司的改制辅导工作，以及双翼科技、瑞柯科技、索信达等多个项目推荐挂牌及后续资本运作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。自执业以来，执业记录良好，未受到监管部门的处罚。

（二）本次证券发行上市的协办人情况

王珊珊女士，保荐代表人，注册会计师，特许公认会计师，特许金融分析师，金融风险管理师，税务师，会计学硕士。2021 年开始从事投资银行业务，曾参与乐舒适（02698.HK）、蜜雪冰城首次公开发行项目及隆利科技（300752.SZ）定向增发项目，具备丰富的财务会计知识和投资银行业务知识。自执业以来，执业记录良好，未受到监管部门的处罚。

（三）项目组其他成员情况

其他参与本次锐石创芯（重庆）科技股份有限公司首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：李飞越、王珏、许添森、范友娟、刘佳智、黄小年、陈泽勇、郭思圻、章亮、郑昊、郭文生、汤丝语、许荣宗。上述人员最近 3 年内执业记录良好，未受到监管部门的处罚。

四、发行人与保荐人的关联关系

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

本保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上海证券交易所相关规定执行。本保荐机构及相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上海证券交易所提交相关文件。若相关子公司参与本次发行战略配售，相关子公司不参与询价过程并接受询价的最终结果。

截至本上市保荐书签署日，广发证券全资子公司广发乾和，直接持有发行人 4.0189% 的股份，广发乾和的员工跟投平台北京擎鼎持有发行人 0.0235% 的股份。除上述情形外，保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在其他持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本上市保荐书签署日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份。

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况

截至本上市保荐书签署日，保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人的控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

截至本上市保荐书签署日，保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系

截至本上市保荐书签署日，保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

第二节 保荐机构的承诺事项

一、本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

本保荐机构同意推荐发行人证券发行上市，并具备相应的保荐工作底稿支持。

二、本保荐机构自愿接受上海证券交易所的自律监管。

第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见

一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论

本保荐机构认为，本项目符合《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件所规定的条件，同意推荐锐石创芯（重庆）科技股份有限公司本次证券发行上市。

二、本次证券发行上市所履行的程序

（一）发行人董事会审议通过

2025年9月29日，发行人召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向及可行性的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市有关事宜的议案》等与本次发行上市有关的议案。

（二）发行人股东大会审议通过

2025年10月14日，发行人召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向及可行性的议案》《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市有关事宜的议案》等与本次发行上市有关的议案。

（三）本次发行取得批复情况

根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委、财政部、证监会令第36号）规定，发行人股东中重庆两江新区开发投资集团有限公司（以下简称“两江开投”）、深圳市福田区产业投资服务有限公司（以下简称“福田产投”）属于需要标注国有股东标识的国有股东。此外，发行人股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）属于《上市公司国有股权监督管理办法》第七十四

条规定的“不符合本办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业，证券账户标注为‘CS’，所持上市公司股权变动行为参照本办法管理”的情形。

截至本上市保荐书出具日，两江开投已取得重庆市国有资产监督管理委员会出具的《关于锐石创芯（重庆）科技股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》，按照上市公司国有股权管理有关规定，在两江开投证券账户加注“SS”；福田产投已取得深圳市福田区国资局出具的《关于锐石创芯（深圳）科技股份有限公司国有股权管理方案的批复》，其在中国证券登记结算有限责任公司登记的投资者一码通账户标注“SS”标识；深创投已出具《关于深圳市创新投资集团有限公司证券账户标识的说明》，确认其证券账户已标注为“CS”。

除此之外，本次发行无需取得国资委、国防科工局等外部审批。

（四）发行人决策程序的合规性核查结论

本保荐机构认为，发行人本次发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序。

三、发行人符合板块定位及国家产业政策的核查情况

（一）发行人符合科创板定位

1、相关说明

根据《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创属性评价指引（试行）》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年4月修订）》等有关规定，发行人符合科创板支持方向、科技创新行业领域和相关指标等科创属性要求，具体情况如下：

（1）发行人符合科创板支持方向

集成电路产业是现代信息产业的基础与核心，对经济社会发展具有全局性影响。射频器件是无线连接的核心基础元件，所有具备无线通信功能的设备均需搭载相应的射频器件。在各类无线通信场景中，包括蜂窝网络（2G/3G/4G/5G）、

Wi-Fi、卫星通信、蓝牙及 NB-IoT（窄带物联网）等主流通信协议，均依赖射频前端模块实现信号的收发与处理。由于不同通信协议对射频前端的设计与性能提出差异化要求，射频器件需兼容多模式、多频段的工作环境。因此，无论终端设备采用何种通信标准或协议，射频器件均为实现可靠无线连接不可或缺的关键组成部分，其性能直接影响到通信系统的整体表现与稳定性。

随着国内手机和物联网模组本土制造崛起，中国成为全球最大的射频前端应用市场，同时也为射频前端的国产企业提供了机遇。全球射频前端行业市场集中度较高，呈现显著的头部效应。高端市场及高集成度射频前端模组领域主要由美国和日本的大型跨国企业主导，其凭借深厚的技术积累和全面的产品布局占据了行业领先地位，市场占有率较高。在国际贸易争端的背景下，国产自主发展高性能射频前端模组的需求愈发强烈，也为国内射频前端企业带来了难得的历史机遇。近年来，国家各部门等陆续出台了多项高新技术产业和战略性新兴产业规划、政策文件等各项规定，例如《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》（发改高技〔2020〕1409 号）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》等，支持射频前端行业的发展。

随着移动通信技术从 3G、4G 向 5G 及未来标准持续演进，终端所需支持的频段数量大幅增加，通信架构复杂度显著提升（如多频载波聚合、MIMO 及 EN-DC 双连接等技术的广泛应用），智能终端的射频前端器件用量大幅增长、射频前端架构趋于复杂。与此同时，以手机为例，受大电池、轻薄化、端侧 AI 应用等驱动，手机主板在结构设计上日趋紧凑，留给射频前端芯片的空间并未同步增加。传统中集成度方案因器件数量多、布局分散，难以满足中高端整机主板空间与性能优化要求。因此，射频前端方案逐步从 Phase 2、Phase 2N、Phase 5N 等中集成度形态，向 Phase 7LE、Phase 8 等高集成度模组形态演进，通过集成化、小型化设计实现更优射频性能、更短研发周期及更低综合成本，已成为技术发展与产业需求的必然方向。

发行人致力于突破射频通信领域的核心关键技术，主营业务为射频前端模组及射频分立器件的研发、设计、制造和销售。发行人产品及技术布局完整，全面

覆盖射频滤波器（含双工器、多工器、SAW Bank）、功率放大器、射频开关及低噪声放大器等全品类核心射频器件，并具备高集成度射频前端模组的快速研发与持续迭代能力。

发行人以研发投入为战略支点，已在芯片设计、滤波器（含双工器、多工器、SAW Bank）晶圆制造、模组集成方案设计、模组封装、量产测试等环节形成了较强的核心竞争力，为发行人不断开发及迭代高端高集成度射频前端产品积蓄了充足势能。此外，发行人积极探索射频前端核心器件国产化方案，推动国产外延和衬底材料、晶圆代工、封装测试、滤波器制造等核心供应链导入终端应用领域，实现射频前端模组材料及制造全环节国产化替代；同时，发行人积极推动射频前端国产供应链实现下游应用端、上游供应链端“双向赋能”，通过技术协同与生态重构，推动射频前端的全面国产化。

核心技术方面，发行人始终坚持创新驱动发展战略，持续开展对射频前端核心芯片及模组化技术的前瞻性研发，并重点布局射频滤波器核心技术与制造工艺。通过持续推进核心滤波器器件的自主设计与制造，发行人有效推动了高集成度、高性能射频前端模组产品的研发与产业化落地，逐步实现射频前端高端高集成度模组核心器件的自主可控。在此过程中，发行人形成了一系列具有自主知识产权的核心技术，并将其持续转化为性能优异、品质可靠的产品，已成为构建发行人核心竞争力的关键支撑。

科技创新能力、科技成果转化情况方面，发行人拥有较为完整的研发体系，目前已掌握了围绕主营业务的 15 项核心技术。发行人将上述核心技术和工艺应用于发行人主营产品的设计、架构设计、工艺适配、封装测试各环节中，推出了诸多高性能、高性价比的射频前端产品，并获得多家知名厂商的高度认可，实现了核心技术产业化。

产品布局方面，依托于在射频前端各关键领域的全面技术布局，发行人已建立起完善的产品矩阵。在模组方面，发行人已推出 L-PAMiD、L-PAMiF、DiFEM、LNA Bank、L-FEM、MMMB PAM、TxM 等核心产品，并针对无人机及卫星通信等新兴应用场景推出专用射频前端模组；在分立器件方面，发行人产品涵盖射频滤波器（含双工器、多工器、SAW Bank）、射频开关、低噪声放大器及天线

调谐开关等。发行人产品类别全面，覆盖高集成度收发模组、高集成度接收模组、中集成度模组及射频分立器件；通信制式完整支持 5G/4G/3G/2G 等蜂窝通信频段，并拓展至无人机通信与卫星通信等新兴领域。目前，发行人已成为国内射频前端产品覆盖范围最广的企业之一，能够充分满足各类终端客户多样化的应用需求。

在射频前端领域技术门槛最高的 L-PAMiD 高集成度收发模组方面，发行人作为国内极少数成功推出搭载自研自产滤波器的全国产化 L-PAMiD 产品的企业，在该领域实现了关键突破。发行人 Phase 8L L-PAMiD 产品采用完全自主设计、自主生产的双工/多工滤波器，真正实现了从芯片设计、滤波器制造到模组封装测试的全流程国产化，产品多项关键性能指标已达到国际一线水准，在双卡场景下具备卓越的谐波性能，成功突破国际射频前端巨头长期垄断的技术壁垒。

综上，发行人符合科创板支持方向。

（2）发行人符合科技创新行业领域要求

发行人所属科技创新行业领域见下表：

发 行 人 所 属 行 业 领 域	<input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术	发行人主营业务为射频前端模组及射频分立器件的研发、设计、制造和销售。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，发行人的行业领域属于第五条第一款第（一）项规定的“新一代信息技术领域”之“半导体和集成电路”。
	<input type="checkbox"/> 高端装备	
	<input type="checkbox"/> 新材料	
	<input type="checkbox"/> 新能源	
	<input type="checkbox"/> 节能环保	
	<input type="checkbox"/> 生物医药	
	<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域	

发行人主营业务为射频前端模组及射频分立器件的研发、设计、制造和销售。发行人主要产品包括射频前端模组产品及射频分立器件产品。发行人产品覆盖高集成度收发模组、高集成度接收模组、中集成度模组、无人机射频前端模组、卫星通信射频前端模组以及射频分立器件，通信制式完整覆盖 5G/4G/3G/2G 等移动通信频段、无人机通信频段以及卫星通信频段。

根据《中华人民共和国国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，发行人所在行业属于“C 制造业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根

据发改委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，发行人所在行业属于“第一类鼓励类”之“二十八、信息产业”之“4、集成电路”。根据发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，发行人所在行业属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 电子核心产业”之“1.3.1 集成电路”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，发行人所处行业属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.4 新型信息技术服务”之“6520 集成电路设计”和“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造”之“3973 集成电路制造”。

综上，根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，发行人的行业领域属于第五条第一款第（一）项规定的“新一代信息技术领域”之“半导体和集成电路”。发行人符合科创板对科技创新行业领域的定位要求。

（3）发行人符合科创属性要求的规定

根据《科创属性评价指引（试行）》（2024 年 4 月修订），发行人符合科创属性评价标准一的要求，具体如下：

科创属性相关指标一	是否符合	指标情况
最近三年研发投入占营业收入比例 5%以上，或最近三年研发投入金额累计在 8,000 万元以上	√是 □否	2022 年度、2023 年度和 2024 年度，发行人累计研发投入合计 74,195.74 万元，占最近三年累计营业收入的比例为 43.96%，超过 5%；最近三年研发投入金额累计超过 8,000 万元。
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	√是 □否	截至 2025 年 6 月末，发行人研发人员为 222 人，占当期员工总数的比例为 59.36%，不低于 10%。
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 7 项以上	√是 □否	截至 2025 年 6 月末，发行人拥有 144 项发明专利，其中应用于发行人主营业务的发明专利为 144 项，超过 7 项。
最近三年营业收入复合增长率达到 25%，或最近一年营业收入金额达到 3 亿元	√是 □否	2022 年度、2023 年度和 2024 年度，发行人营业收入分别为 37,000.09 万元、64,913.01 万元和 66,860.93 万元，最近三年营业收入复合增长率为 34.43%，超过 25%；且最近一年营业收入金额超过 3 亿元。

综上所述，发行人符合科创板支持方向、科技创新行业领域和相关指标等科创属性要求。

2、保荐人核查程序

保荐人履行了如下核查程序：

- （1）通过公开渠道查询发行人主营业务所处细分行业资料；
- （2）访谈发行人研发部门负责人及其他核心技术人员，了解发行人的核心技术平台及技术先进性；
- （3）查阅发行人获得授权的专利情况、承担项目课题任务情况；
- （4）查阅研究报告及同行业公司资料，向发行人了解现有核心技术中能够衡量发行人核心竞争力或技术实力的关键指标、具体表征及与可比公司的比较情况、核心技术的先进性，在境内与境外发展水平中所处的位置等；
- （5）查阅公司各项研发内部管理制度，核查研发部门设置、研发支出范围、标准与审批流程等；
- （6）查阅发行人在研产品内部立项文件及相关报告，了解发行人在研产品的技术先进性及相关的性能、指标参数；查阅同行业公司产品规格书等；查阅公司正在从事的主要研发项目、承担的重要科研项目情况；
- （7）查阅发行人获得的重要奖项及荣誉称号；
- （8）通过国家有关部门网站查阅国家相关产业政策及行业分类文件；
- （9）查阅申报会计师出具的审计报告，核查发行人报告期内营业收入、研发投入变动及其构成情况；
- （10）查阅行业研究报告、同行业公司招股说明书、年度报告及其他公开信息披露文件等。

3、保荐人核查结论

综上所述，发行人符合科创板支持方向、科技创新行业领域和相关指标等科创属性要求，符合科创板定位。

（二）发行人符合国家产业政策

1、相关说明

发行人主营业务为射频前端模组及射频分立器件的研发、设计、制造和销售。发行人产品及技术布局完整，全面覆盖射频滤波器（含双工器、多工器、SAW Bank）、功率放大器、射频开关及低噪声放大器等全品类核心射频器件，并具备高集成度射频前端模组的快速研发与持续迭代能力。

发行人所处行业属于国家重点支持的领域，《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》将集成电路芯片设计及服务认定为新一代信息技术产业，《战略性新兴产业分类（2018）》将集成电路设计划分为战略新兴产业中的新型信息技术服务；根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，集成电路设计为“鼓励类”的信息产业。此外，“十四五”规划明确指出，要瞄准集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目，实现集成电路先进工艺和微机电系统（MEMS）等特色工艺突破。

综上，发行人所处行业是产业结构调整和鼓励类项目，符合国家产业政策。

2、保荐机构核查程序

保荐人履行了如下核查程序：

- （1）通过国家有关部门网站查阅国家相关产业政策及行业分类文件；
- （2）查看发行人实际生产经营活动流程，查阅发行人与主要客户签署的合同；
- （3）查阅申报会计师出具的审计报告，核查发行人主营业务收入构成情况；
- （4）查阅行业研究报告、同行业公司招股说明书、年度报告及其他公开信息披露文件等。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，发行人主营业务符合国家产业政策。

四、本次发行符合上市条件

本保荐机构依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）的相关规定，对发行人是否符合上市条件进行了逐项核查。经核查，本保荐机构认为发行人符合《科创板上市规则》规定的上市条件，具体情况如下：

（一）发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条之“（一）符合中国证监会规定的发行条件”

本保荐机构依据《首次公开发行股票注册管理办法》，对发行人的发行条件进行逐项核查，认为：

1、发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十条的规定

保荐机构核查了发行人设立至今的工商登记资料、营业执照、公司章程、创立大会相关文件、审计报告、评估报告、验资报告、内部控制制度、历次三会决议文件等相关资料。经核查，发行人是依法设立且合法存续的股份有限公司，于 2021 年 12 月 20 日由锐石创芯（深圳）科技有限公司以截至 2021 年 8 月 31 日经审计的账面净资产折股整体变更为股份有限公司。锐石创芯（深圳）科技有限公司于 2017 年 4 月 1 日成立，自有限责任公司成立之日起计算，发行人依法设立且持续经营已超过三年。

发行人已依法建立了股东会、董事会（下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会）、管理层等决策、经营管理及监督机构，已根据相关法规建立了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度并良好执行。经保荐机构核查，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

综上，发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十条的规定。

2、发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十一条的规定

保荐机构查阅了发行人的财务管理相关制度，抽查了相关会计凭证和文件资

料等，确认发行人会计基础工作规范；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（致同审字（2025）第 441A034880 号）。发行人财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。

保荐机构查阅了发行人的内部控制制度，检查了关键业务流程的内部控制相关凭证资料。发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（致同审字（2025）第 441A035000 号），发行人于 2025 年 6 月 30 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

综上，发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十一条的规定。

3、符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条的规定

保荐机构核查了发行人实际控制人的对外投资及任职情况，获取了控股股东及实际控制人出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，审阅了发行人报告期内的关联交易情况，查阅了发行人工商登记档案、主要资产权属证明文件、重要业务合同等资料，访谈了发行人实际控制人、董事、审计委员会委员、高级管理人员、核心技术人员及相关员工。保荐机构认为，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条第一款的规定。

保荐机构核查了发行人的工商登记资料、公司章程、“三会”会议文件及历次融资协议，获取了发行人现任董事、审计委员会委员、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况调查表，并对发行人实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员及其他主要股东进行了访谈，同时获取并审阅了发行人的重要业务合同。保荐机构认为，发行人主营业务、控制权和管理团队稳定，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员、核心技术人员稳定且没有发生重大不利变化。发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条第二款的规定。

保荐机构核查了发行人主要资产、商标、专利等权属情况，获取并审阅了企业信用报告、发行人律师出具的法律意见书，从相关主管部门取得了合规证明，并通过公开网络渠道对发行人相关信息进行了检索与验证。保荐机构认为，发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条第三款的规定。

4、符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条的规定

保荐机构获取并查阅了相关主管部门出具的合规证明，发行人及控股股东、实际控制人出具的声明与承诺，以及实际控制人、董事、审计委员会委员、取消监事会前在任监事、高级管理人员的无犯罪记录证明；同时，通过全国企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台等公开渠道对相关信息进行了查询与核验。保荐机构认为，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策；最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；董事、审计委员会委员、取消监事会前在任监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条的规定。

综上所述，本保荐机构认为，发行人本次发行符合中国证监会有关规定。

（二）发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于 3,000 万元”及“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过四亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”

保荐机构核查了发行人设立至今的工商登记资料、本次首次公开发行股票并上市的董事会及股东会议案、决议等资料。发行人本次发行前总股本为 43,444.8089 万股，本次拟公开发行股份不低于 4,827.2010 万股（不含采用超额

配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于 10%，发行后股本总额不低于 48,272.0099 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于人民币 3,000.00 万元。

综上，保荐机构认为，发行人符合上述上市标准规定的上市条件。

（三）发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条之“（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准”

根据《科创板上市规则》规定的上市条件，发行人符合上市条件中的 2.1.2 条第（二）项：预计市值不低于人民币 15 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 2 亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%。具体分析如下：

1、预计市值不低于人民币 15 亿元

基于发行人业绩情况，并结合报告期内发行人的外部股权融资估值情况、可比上市公司在境内二级市场的估值情况，发行人预计总市值不低于 15 亿元。

2、最近一年营业收入不低于人民币 2 亿元

保荐机构查阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字（2025）第 441A034880 号），发行人最近一个完整会计年度即 2024 年度营业收入为 6.69 亿元，不低于 2 亿元。

3、最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%

保荐机构查阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字（2025）第 441A034880 号），发行人最近三年累计研发投入合计 7.42 亿元，占最近三年累计营业收入的比例为 43.96%，满足最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%的要求。

综上，保荐机构认为，发行人符合上述上市标准规定的上市条件。

（四）发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条之“（五）本所规定的其他上市条件”

经核查，发行人符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

综上所述，本保荐机构认为，发行人本次发行上市符合《科创板上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的上市条件。

五、保荐机构对发行人持续督导工作的安排

事项	安排
（一）持续督导事项	在本次发行结束当年的剩余时间以及以后 3 个完整会计年度内对发行人进行持续督导。
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	强化发行人严格执行中国证监会有关规定的意识，协助发行人制订、执行有关制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，确保保荐机构对发行人关联交易事项的知情权，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	协助和督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若关联交易为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公司章程》等规定执行，对重大的关联交易本保荐机构将按照公平、独立的原则发表意见。
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定，适时审阅发行人信息披露文件。
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	建立与发行人信息沟通渠道，根据募集资金专用账户的管理协议落实监管措施，定期对项目进展情况进行跟踪和督促。
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担保行为的决策程序，要求发行人对所有担保行为与保荐机构进行事前沟通。
7、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作	严格按照中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作对发行人进行持续督导。
（二）保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作；有充分理由确信发行人或相关当事人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，应督促发行人或相关当事人做出说明并限期纠正，情节严重的，应当向中国证监会、交易所报告；可要求发行人或相关当事人按照法律、行政法规、规章、交易所规则以及协议约定方式，及时通报信息；可列席发行人或相关当事人股东大会、董事会、审计委员会等有关会议；按照中国证监会、交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明。

事项	安排
（三）发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定	发行人协调相关当事人配合保荐机构的保荐工作，并督促其聘请的其他证券服务机构协助保荐机构做好保荐工作。
（四）其他安排	无。

六、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

法定代表人：林传辉

保荐代表人：陈昊田、鲁学远

联系地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

邮编：510627

电话：020-66338888

传真：020-87553600

七、保荐机构认为应当说明的其他事项

本保荐人无其他应当说明的事项。

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于锐石创芯（重庆）科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页）

项目协办人：

王珊珊

王珊珊

保荐代表人：

陈昊田

陈昊田

鲁学远

鲁学远

内核负责人：

崔舟航

崔舟航

保荐业务负责人：

胡金泉

胡金泉

保荐机构法定代表人（董事长）：

林传辉

林传辉

保荐机构（公章）：广发证券股份有限公司

2025年12月26日

